

2026 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

THECA Show 2026 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 8 月 26 日（水）～8 月 28 日（金）にバンコク International Trade & Exhibition Centre（BITEC）で開催される「THAILAND ELECTRONICS CIRCUIT ASIA 2026」（THECA）に出展いたします。



本展示会はタイ・プリント回路協会（Thailand Printed Circuit Association）が主催し、プリント基板（PCB）やプリント基板実装（PCBA）に焦点を当てた、タイのエレクトロニクス製造業向けの国際展示会です。

当社ブースでは、高密度化・複雑化が進む回路基板に対し、検査治具の接点から内部の欠陥検出に至るまで、総合的な品質管理ソリューションを提案いたします。高い信頼性を誇る電気検査装置は、高密度基板や多層基板を効率的に処理し、スムーズな生産フローを実現。また、カスタマイズされた高精度治具が安定した接続を確保し、誤判定を防ぐことで、生産ライン全体の検査効率を大幅に向上させます。さらに今回は、テクノホライゾン社と共同開発した、複雑な電子部品や基板内部を鮮明に検査できる最新の X 線検査装置を、タイで初披露いたします。

〈出展概要〉

- ・会期：2026 年 8 月 26 日（水）～28 日（金）
- ・会場：バンコク International Trade & Exhibition Centre
- ・ブース：R13
- ・公式サイト：<https://thailandelectronicscircuitasia.com/>

〈主な展示内容〉

- ・バックドリル検査用高速 CT 型 X 線検査装置
- ・HDI/PCB 基板向け導通/短絡検査装置「STAR REC[®]シリーズ」
- ・半導体パッケージ対応導通/短絡検査装置「GATS[®]シリーズ」
- ・大判基板向け導通/短絡検査装置「GATS[®]8360」
- ・2D/3D wafer Bump 検査装置「RWi-300MK3」
- ・3D/AFVI AI 検査システム「AURCA Series」
- ・高密度基板対応光学式 2D/3D 検査装置「RSH シリーズ」
- ・高精度検査治具